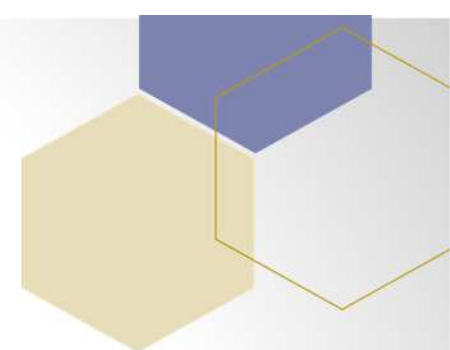




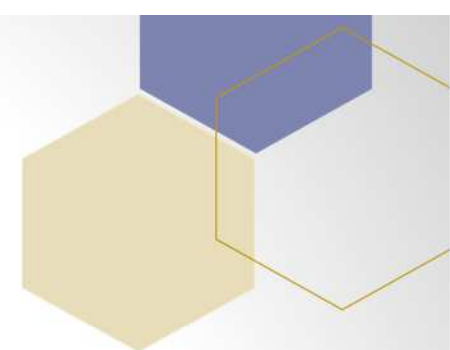
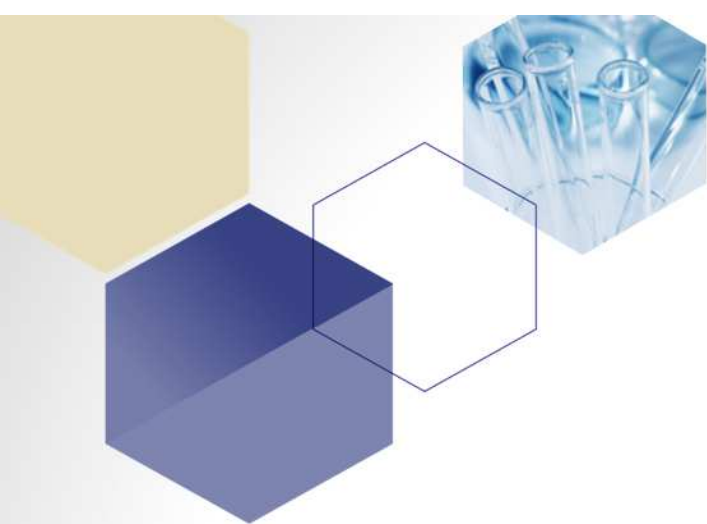
2027年3月期 第1四半期 決算説明資料



日本高純度化学株式会社

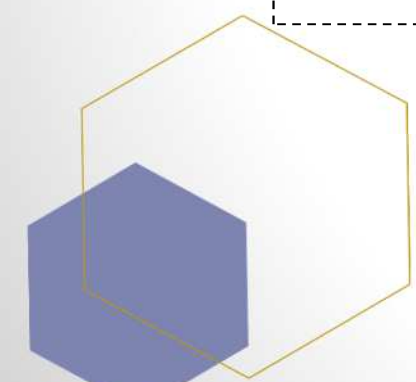
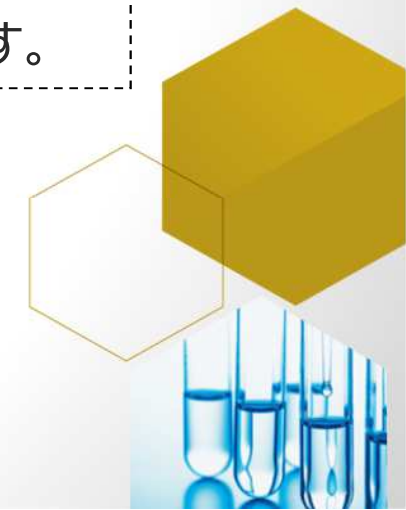
証券コード：4973

2026年7月24日



決算の概況

(注) 当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合によって大きく変動します。
 - 貴金属は価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 
- 

めっき方式の説明

用語	最終用途	説明
電解めっき	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	PC・スマホ等のプリント基板（CPU・GPU等）	高純度な純金めっき
硬質金めっき	スマートフォン・車載・産業機械等のコネクタ	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウムめっき	PC・車載・産業機械等のリードフレーム	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換金めっき	DRAM・NAND等の半導体メモリ サーバ・PC・スマートフォン等の半導体 パッケージ基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元金めっき	半導体パッケージ基板 サーバ・PC等のCPU・GPU等	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法
還元パラジウムめっき	サーバ・PC等の半導体パッケージ基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法（金めっきの下地として使用される）

製品ラインアップ

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	テンペレジストシリーズ
	硬質金		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元パラジウム		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属（銅、スズ、ニッケル）、合金めっき、後処理剤など	

めっきプロセスの説明

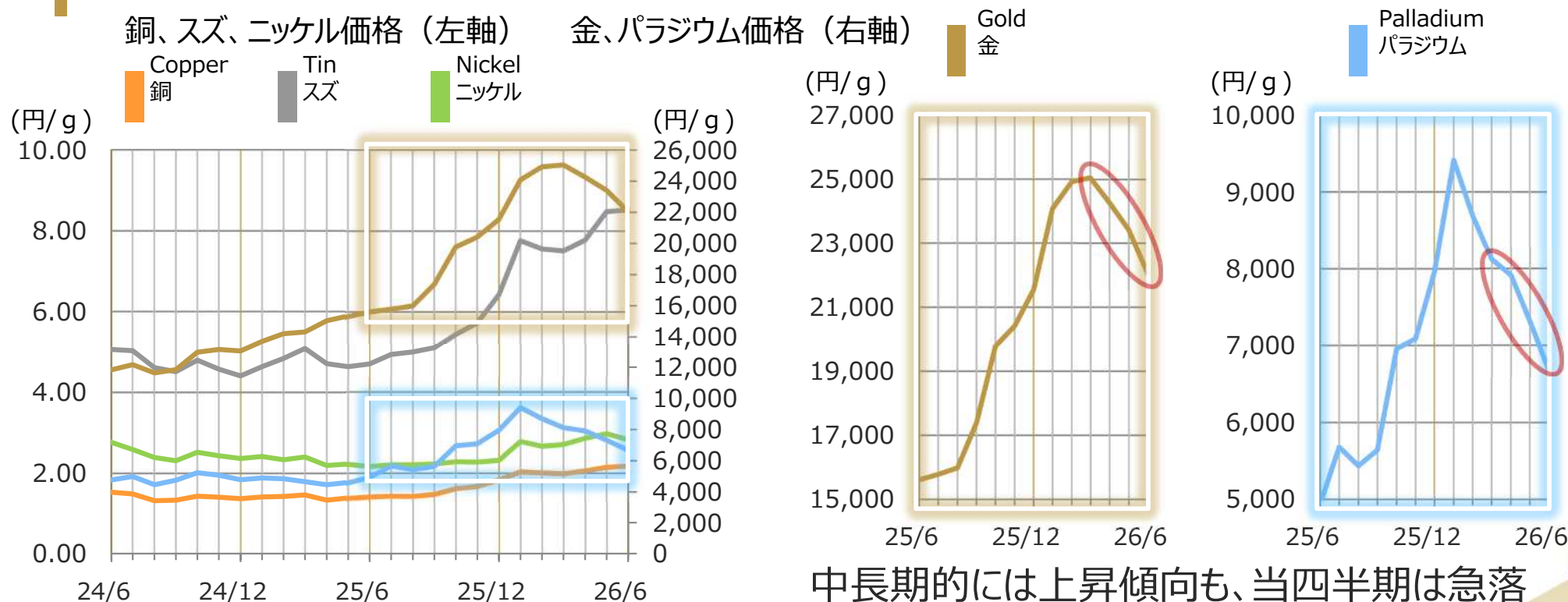
用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Ni-Au Electroless Nickel Immersion Goldの略	Au 0.06μm Ni 2-7μm Cu 15-30μm
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法 薄ニッケル化の動きが進んでいる。 層構成はCu-Ni-Pd-Au Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略	Au 0.06μm Pd 0.04μm Ni 0.15-7μm Cu 15-30μm
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。 層構成はCu-Au Direct Immersion Goldの略	Au 0.06μm Cu 15-30μm
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Pd-Au Electroless Palladium Immersion Goldの略	Au 0.06μm Pd 0.04μm Cu 15-30μm

2027年3月期 第1四半期外部環境

電子部品業界の状況

- 電子部品業界では、ハイパースケーラーによるAIインフラ投資の拡大を背景に、AIサーバ・データセンター向け需要が大きく伸長し、FA機器など産業機器向けも堅調に推移
- パソコンやスマートフォンなどの民生機器向けは、メモリ価格高騰の影響により需要が鈍化
- 車載用電子部品については、ADAS（Advanced Driver Assistance Systems）やSDV（Software Defined Vehicle）の普及が需要を下支えしたものの、米国における電気自動車政策の見直しや中国の内需減速の影響を受け、需要の伸びは限定的

貴金属の概況



2027年3月期 第1四半期決算概況

当社の決算概況：増収減益

- 売上高：スマートフォンやパソコンなど民生向け需要が概ね堅調に推移したことに加え、生成AI関連需要の拡大を背景に、半導体パッケージ・モジュール向け及びメモリ向けの販売が好調に推移また、前年同期比で貴金属価格の上昇※1も寄与し、前年同期比80.6%の増収
- 営業利益：販売数量の増加により粗利益は増加したものの、3月末から6月末にかけての貴金属価格下落※2に伴う一過性の要因により、前年同期比△66.3%の減益
- 四半期純利益：営業利益の減少を受け、前年同期△34.5%の減益

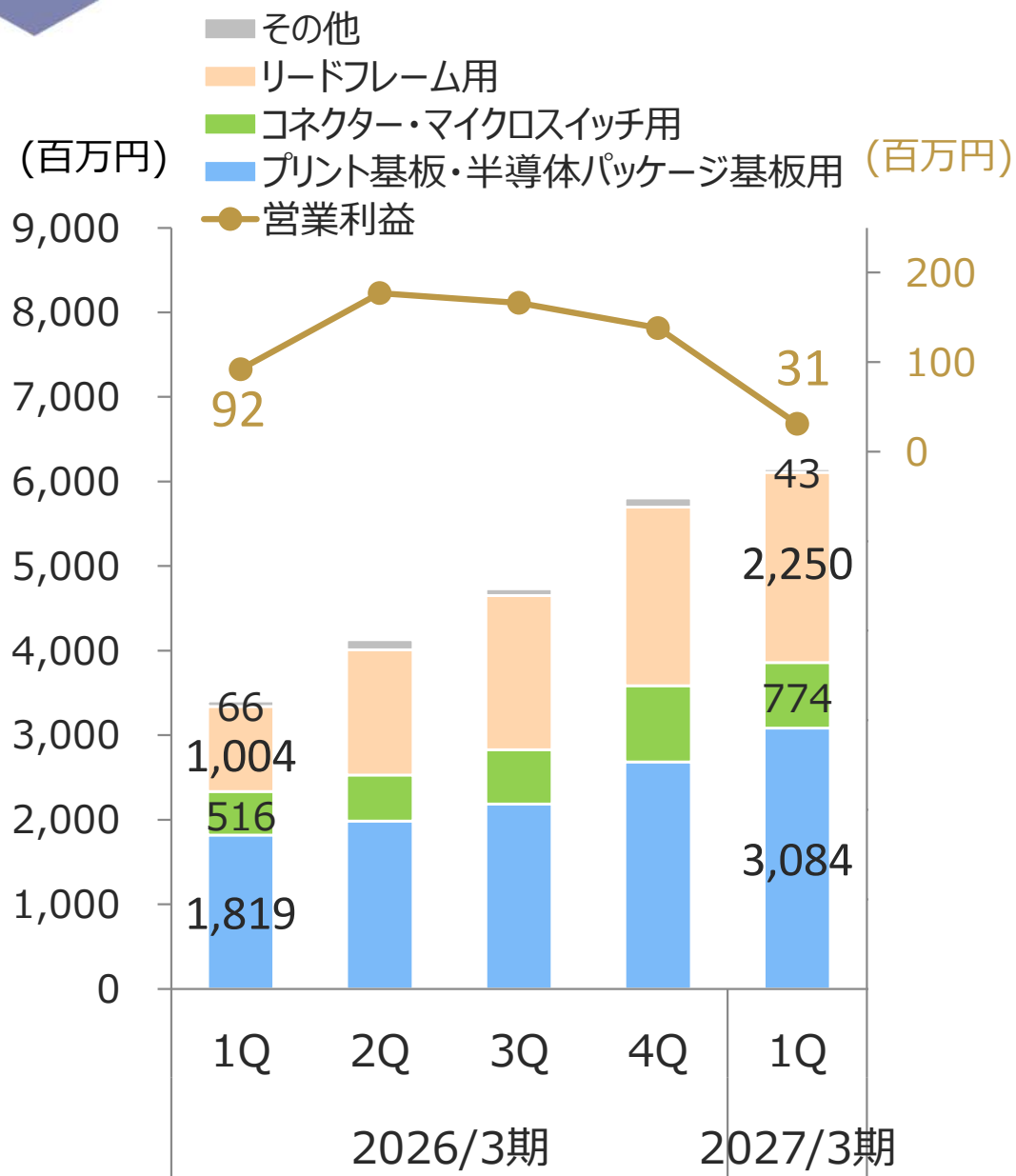
(単位：百万円)	2026/3期	2027/3期			
	1Q	1Q	増減率	年間予想	第一四半期 進捗率
売上高	3,406	6,152	+80.6%	24,000	25.6%
営業利益	92	31	△66.3%	610	5.1%
経常利益	184	122	△33.4%	800	15.4%
四半期純利益	135	88	△34.5%	2,170	4.1%
1株当たり 四半期純利益	23.40円	15.25円	—	—	—

貴金属価格（単月平均、1gあたり）

※1 前年同期比（2025年6月→2026年6月） 金：15,612→22,042円、パラジウム：4,942→6,671円

※2 前四半期比（2026年3月→2026年6月） 金：25,047→22,042円、パラジウム：8,116→6,671円

売上高・営業利益の推移

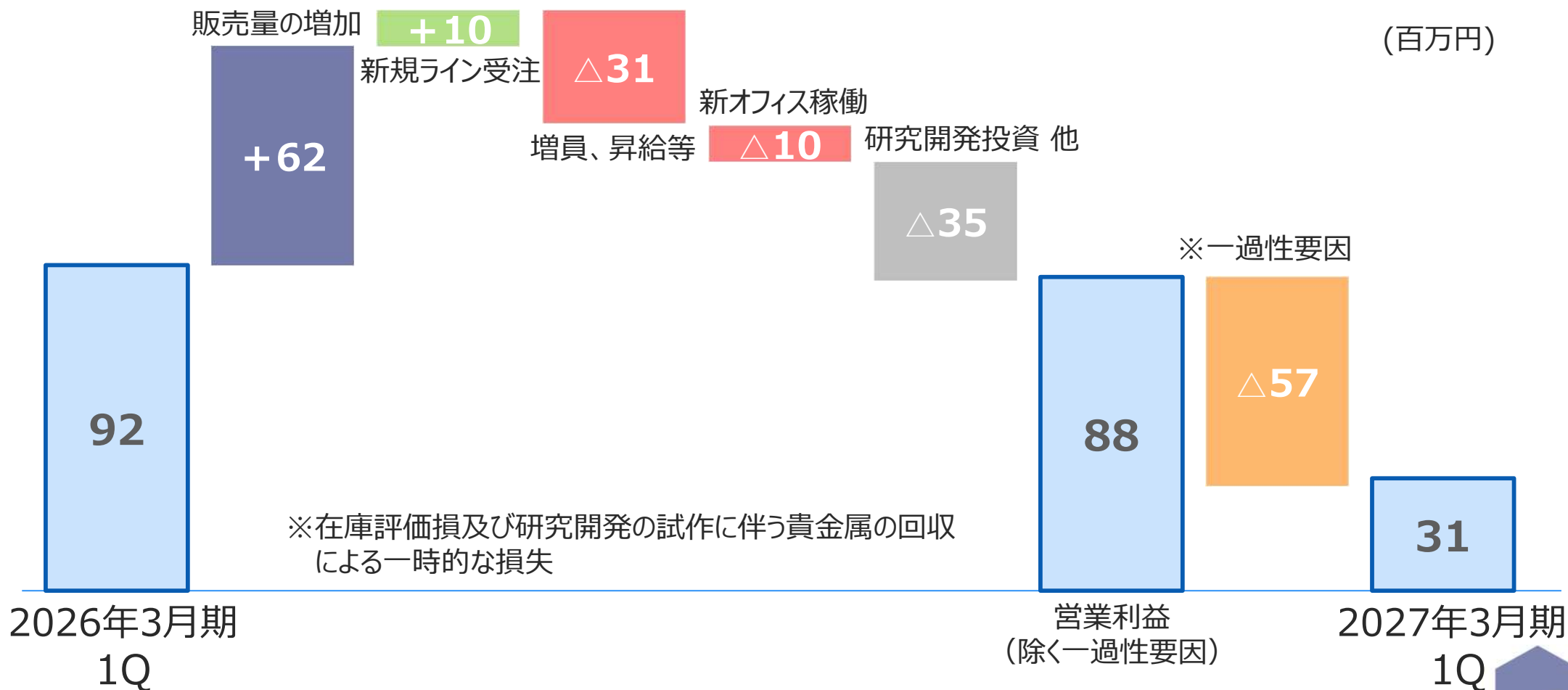


カテゴリー別概況（前年同期比）

- プリント基板・半導体パッケージ基板用めっき薬品
AIサーバ向け需要を背景に、半導体パッケージ、モジュール及びメモリ向けが好調で、スマートフォン・パソコン向けもハイエンド製品を中心に堅調に推移し、貴金属価格上昇の影響もあり増収
- コネクタ用めっき薬品
スマートフォン向け及び車載向けは横ばいで推移、産業機器向けの需要増加により増収
- リードフレーム用めっき薬品
民生・車載向けに改善が見られ、データセンター向け需要が大幅に増加したことに加え、貴金属価格上昇の影響もあり増収

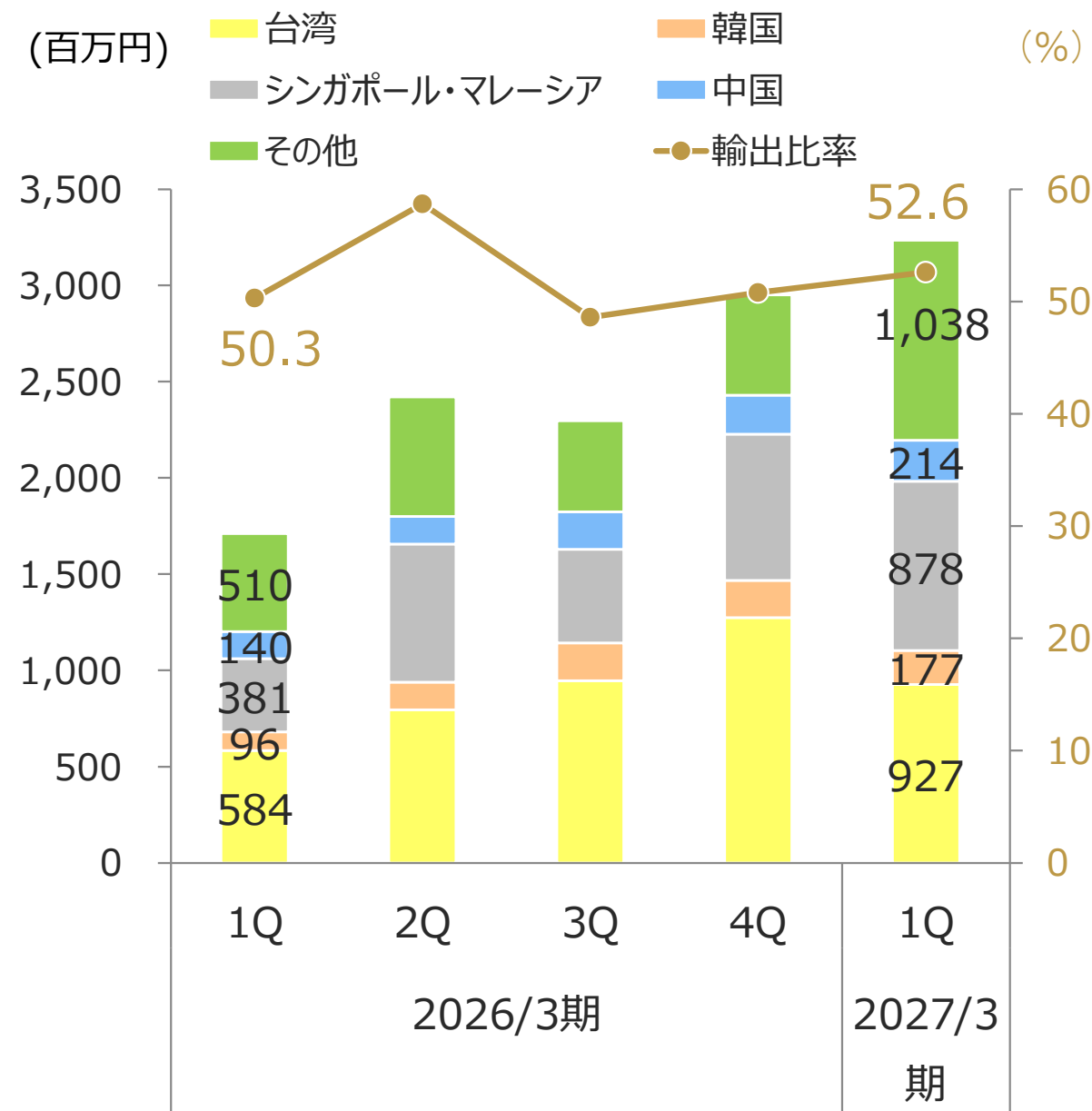
営業利益増減要因（前年同期比）

- AI関連需要を背景にメモリ向けが好調を維持したほか、コネクタ、PCB、リードフレーム向けもスマートフォン、産業機器、民生向け需要の回復を背景に堅調に推移し、販売数量は増加
- 人的資本や研究開発への先行投資を販売数量の増加に伴う粗利益増により概ね吸収、貴金属価格下落に伴う一過性の要因により、営業利益は減少



注）当社は為替予約により為替変動の影響を最小限に留めています

輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



増減理由（前年同期比）

- 台湾
AIサーバ向け光通信モジュール及び民生向けリードフレーム用途が堅調に推移し、貴金属価格の上昇も背景に増収
- シンガポール・マレーシア
民生・産業機械向けのリードフレームが回復傾向にあり、パソコン・サーバ向けパッケージ用途も堅調に推移し、貴金属価格の上昇も背景に増収
- その他
フィリピンにおけるパソコン・サーバ向けパッケージ用途の需要増により増収

2027年3月期 見通し

- AIサーバ・データセンター向け需要は引き続き堅調、産業機器向け需要も回復基調
- メモリ供給の制約により一部民生向け需要の回復は緩やかなものの、AI関連需要は引き続き旺盛
- 人的資本・研究開発への投資を継続し、中長期的な成長基盤を強化
- 第1四半期における急激な貴金属価格変動による影響は限定的と見込み、通期予想に変更なし

(単位：百万円)	2026/3期	2027/3期	前期比
売上高	18,073	24,000	+32.8%
営業利益	576	610	+5.8%
経常利益	776	800	+3.1%
投資有価証券売却益	1,655	2,100	+26.8%
当期純利益	1,803	2,170	+20.3%
1株あたり配当	200円	230円	+30円
ROE	11.5%	12.1%	—

政策保有株式売却の進捗

- 当社は政策保有株式について、中期経営計画 FY2025-2027の期間中に純資産割合を20%未満に縮減する方針を掲げています
- 保有銘柄の株価が大きく上昇したことにより、結果として保有株式の時価は前年度末から増加しました
- 期初に策定した政策保有株式の売却計画に変更はありません

	2025年 6月末	2025年 9月末	2025年 12月末	2026年 3月末	2026年 6月末
売却額 ※（百万円）	—	493	933	315	—
保有株式時価（百万円）	6,740	8,416	9,308	10,743	17,956
純資産額（百万円）	13,891	15,566	16,659	18,064	22,315
純資産に対する割合（%）	48.5	54.1	55.9	59.5	80.5

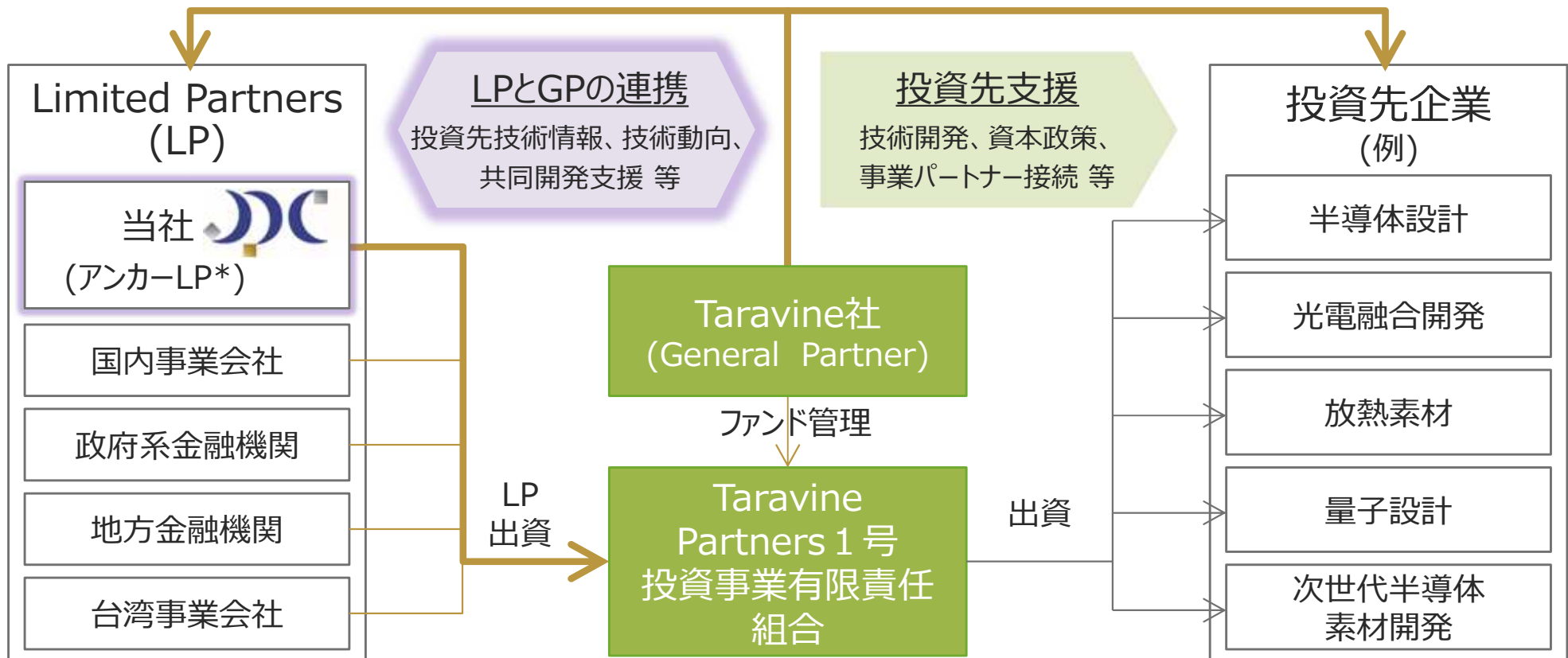
※ 該当四半期中での売却額

トピック:半導体領域への投資に特化したVCファンドへの出資

背景・狙い

- 当社の事業・戦略との親和性が高い、次世代半導体素材、次世代半導体パッケージング技術等の分野における有望なアーリーステージ企業を主な投資対象とするファンド
- 出資を通じた投資先企業の成長支援と、将来の連携先としてのタッチポイント確保
- ファンドの運営管理会社を通じた市場探索やネットワークの活用

ファンドのビジネススキーム（イメージ）



* アンカーLP:ファンドの立上げ段階から主要出資者として参画する投資家

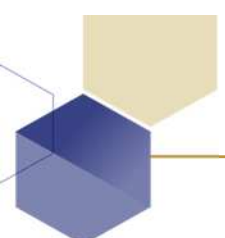
補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7 月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3 月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3 月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2 月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4 月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4 月 東京証券取引所プライム市場に移行
- 2026年 3月 成増オフィス開設

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを保有しないファブライト企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2026年6月末時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>